证券代码：688312 **证券简称：燕麦科技**

深圳市燕麦科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☑特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（电话会议）
参与单位名称	中邮证券、诺德基金
时间	2026年11月11日 15:00
地点	公司三楼会议室
公司接待人员姓名	董事会秘书 姜铁君
投资者关系活动主要内容介绍	**1、公司前三季度经营情况如何？** 答：前三季度营业收入同比小幅下降，利润总额降幅大于收入，主要受消费电子行业周期、新业务尚处爬坡期以及汇兑损益等因素共同影响。 **2、主业下游设备需求主要由什么因素驱动？** 答：主业设备需求主要取决于终端产品内部元器件的变化，而非整机外形更迭。元器件创新带来新测试需求时，客户需新增设备。 **3、公司主营业务及行业地位如何？** 答：公司主营业务为 FPC 自动化测试设备的研发、生产与销售，产品以定制化设备为主，主要应用于消费电子领域。通过多年的研发和实践，公司积累了丰富的项目实施经验，凭借高效迅速的客户服务等优势，已成为 FPC 行业头部企业的核心供应商。公司客户覆盖全球前十大 FPC 企业中的八家，并已经发展成为全球消费电子领先品牌苹果、谷歌等公司的供应商。优质的头部客户资源奠定了公司

	在 FPC 测试领域的领先地位。 **4、FPC 测试设备的竞争壁垒体现在哪些方面？** 答：主要有四方面。（1）定制化带来的占位优势，在终端客户产品概念设计便协同研发设计，提前介入，形成稳固占位优势。（2）工艺积累，FPC 轻薄柔软、形态立体，抓取定位和测试难度大，相关经验依赖长期积累。（3）行业竞争格局稳定，FPC 测试设备是产业链关键细分装备领域，大型设备厂商缺乏重点投入的动力，小规模厂商又难以承担相应的技术和人才投入。（4）上市后提升了品牌影响力，增加了公司的软硬实力，抵御行业竞争的底气充足。 **5、公司在半导体测试领域的布局是怎样的？** 答：公司在半导体领域选择了三个具有前瞻性的细分方向，按晶圆级、封测级、器件级三个层次展开：晶圆级为硅光晶圆测试，封测级为高端 IC 载板测试，器件级为 MEMS 微机电器件测试（温湿压传感器、IMU）及 ATE 自动化测试仪表。选择上述方向，主要考虑相关领域国产化率较低、进口替代空间较大；高端 IC 载板与 FPC 测试有很多地方相似，公司精密测试与自动化能力可直接复用；且细分赛道技术壁垒较高，竞争格局相对清晰。 **6、MEMS 方向的推进情况如何？** 答：公司 MEMS 测试设备已在头部声学及传感器客户的压力传感器产线批量应用，形成稳定的量产合作。同时，公司依托该量产案例向其他客户拓展，IMU 等新品已完成多家客户送样。该方向客户集中度较高、新客户导入周期较长，公司正持续推进客户结构多元化。 **7、IC 载板方向的进展如何？** 答：该产品线已实现 2 台销售并完成交付，客户使用情况良好；同时已向多家头部厂商送样验证，测试数据反馈积极。产品性能对标国际同类设备，在价格与本地化服务方面具备一定优势。该产品标准化程度相对较高、验收周期较短，是公司重点推进的方向之一。

	8、硅光晶圆测试业务的进展如何？ 答：公司硅光晶圆测试设备的主要客户因被收购，我们在根据新客户验证后提出的改进意见进行设备的改造和升级。我们的交付计划需要与客户的总体规划保持一致。行业层面，硅光处于产业化初期，各厂商相关业务收入占比暂低于此前市场预期，技术方向未变、落地节奏有所延后。 **9、公司在光领域的其他布局有哪些？** 答：公司已设立光互联事业部。除测试设备外，公司参股了亿源通，其主要产品为 FAU 及 MPO 连接器，下游应用为数据中心光连接。公司为其提供组装与测试自动化设备，双方可在产品与客户资源上形成协同。 **10、公司对后续经营有何展望？** 答：公司将继续巩固FPC测试基本盘，推进IC载板、MEMS、硅光及光领域产品的研发、销售工作，并通过内部效率提升控制成本，公司在技术扩张上，内生和外延并用。
附件清单（如有）	无
时间	2026年11月11日